

## 深圳市江波龙电子股份有限公司

### 2025 年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形

单位：万元

| 项 目               | 本报告期      |         |           | 上年同期         |
|-------------------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 归属于上市公司<br>股东的净利润 | 125,000   | ~       | 155,000   | 49,868.45    |
|                   | 比上年同期增长   | 150.66% | ~         | 210.82%      |
| 扣除非经常性损<br>益后的净利润 | 113,000   | ~       | 135,000   | 16,654.26    |
|                   | 比上年同期增长   | 578.51% | ~         | 710.60%      |
| 营业收入              | 2,250,000 | ~       | 2,300,000 | 1,746,365.03 |

注:本表格中的“万元”均指“人民币万元”。

#### 二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经预审计。深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告有关事项与年报审计的注册会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。

#### 三、业绩变动原因说明

1、报告期内，存储价格在一季度触底后企稳回升，三季度末因 AI 服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜，导致供给进一步失衡，存储价格持续上涨。

公司依托高端产品布局、海外业务拓展及自有品牌优势，上半年实现扭亏为盈，下半年盈利水平稳步提升，第四季度扣非净利润约为 6.5 亿元至 8.7 亿元。

2、报告期内，公司多款主控芯片已经实现批量应用，并成功完成 UFS 4.1 主控芯片的首次流片，成为全球少数具备该代际主控芯片自研能力的企业。依托主控芯片、固件算法、封装测试的全栈能力，公司已与多家晶圆原厂及头部智能终端设备厂商构建了深度合作关系，以 UFS 4.1 为代表的旗舰存储产品正在批量出货前夕。同时，公司已经实现定制化端侧 AI 存储产品在头部客户的批量出货。报告期内公司还推出了 Wafer 级 SiP 封装的 mSSD 产品，正在多家头部 PC 厂商加快导入。上述技术布局与深度协同机制，使公司在晶圆供应结构性偏紧的环境下，构建起了差异化的供应保障能力与成长潜力。

3、报告期内，公司延续提质增效管理方针，整体费用率较 2024 年有所回落，运营效率进一步提升，有效支撑高端产品放量与供应链韧性建设。

4、报告期内，公司股份支付费用约为 9000 万元，公司持续加大研发投入和人才储备力度，夯实公司的核心竞争力及健全公司长效激励机制。

5、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 1 亿元至 2 亿元，主要为金融资产产生的公允价值变动所致。

#### 四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经审计机构审计。  
2、2025 年年度业绩的具体数据将在公司《2025 年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、董事会关于本期业绩预告的情况说明；  
2、深交所所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日